

科德数控股份有限公司

关于增加公司及控股子公司申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次公司及控股子公司拟向中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行增加人民币 0.5 亿元的综合授信额度。
- 本次综合授信额度属于董事会审批范围，无需提交股东大会进行审议。

2022 年 5 月 24 日，科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》，具体情况公告如下：

公司已于 2022 年 4 月 7 日分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》，公司及控股子公司向金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，其中向中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-022）。

鉴于目前公司业务发展需求情况，本次公司及控股子公司拟向中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行增加人民币 0.5 亿元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及控股子公司拟向中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行申请的综合授信额度合计不超过人民币 1.5 亿元。

本次授信期限为自董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，授信业务范围包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、押汇、保函等信贷业务。担保方式为信用、保证、抵押及质押等，具体提供担保的情况、担保方式及担保期限等以各相关银行最终核定并签订相关担保合同约定的内容为准。

本次增加的综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。具体的授信额度、期限以及授信业务范围以银行最终核定并签订相关合同约定的内容为准。

董事会授权经营管理层根据公司及控股子公司业务开展的需要，在上述额度内办理综合授信及担保事宜相关手续并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件），涉及超过董事会审议权限的担保事项，公司将履行相应的股东大会审议程序并及时进行公告。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日